



DuraForce EX

KC-S703/KC-S603

現場業務をこの一台に。
堅牢性と信頼性を兼ね備えた高耐久スマホ。

SIMフリー/Wi-Fi



京セラ DuraForce EXは高耐久スマートフォンで、米国国防総省調達基準のMIL規格と独自の耐久試験 計31項目に準拠。高さ約1.8mからコンクリートへの落下を想定した耐久試験や、温度耐久、耐薬品など各種試験をクリア。安心して長くお使いいただける製品です。

弊社は、DuraForce EXをサーボトータルステーションTrimble Sシリーズのコントローラとして採用しました。Trimble Sシリーズとは、Bluetoothで接続しコントロールしますのでツーマンでの観測、ワンマンでの観測どちらでも行うことができます。





[主な仕様] DuraForce EX(デュラフォースイーエックス)

ディスプレイ		約5.8インチ HD+ TFT液晶 (HYBRID SHIELD®搭載)	Wi-Fi	IEEE802.11a/b/g/n (2.4/5GHz) / ac IEEE802.11r®/k®/v®/w (Wi-Fi高速ローミング) (※部分的対応)
サイズ (幅×高さ×厚さ)		約77 x 163 x 14.9 mm	衛星測位システム	GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/Galileo対応
重量		約248g		
バッテリー容量		4,270mAh	Bluetooth®	Ver. 5.3
OS		Android™14	外部接続	USB Type-C™/イヤホンジャック (3.5φ)
CPU		MediaTek Dimensity 700 2.2GHz(2コア)+2.0GHz(6コア)	耐衝撃/防水/防塵	耐衝撃(MIL-STD-810H 21項目)+京セラ独自試験 防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP6X)
カメラ	メイン (アウト)	約1600万画素CMOS (ワイド撮影切替可能)	NFC/Felica	○ / ○ (おサイフケータイ®対応)
	サブ (イン)	約800万画素CMOS	FMラジオ	○
メモリ	内蔵	RAM : 4GB/ROM : 64GB	sXGP	○
	外部	microSDXC™(最大1TB)	生体認証	顔認証 (Class2) / 指紋 (Class3)
対応SIM		Dual SIM (nano SIM+eSIM)	付属品	ACアダプタ
通信方式		5G (SA対応※) / 4G / 3G / 2G (※SA対応のSIMが必要になります。)		

※「DURA FORCE」、「ハイブリッドシールド」、「HYBRID SHIELD」、「グローブタッチ」、「ウェットタッチ」、「JAPAN MADE (ロゴ)」は、京セラ株式会社の登録商標です。※LTEは、ETSIの商標です。※Android は Google LLC の商標です。
 ※Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京セラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。※USB Type-CはUSB Implementers Forumの商標です。※microSD、microSDXCはSD-3C, LLCの商標です。※ Dragontrail®はAGC Inc.の登録商標です。※おサイフケータイ®は、株式会社NTTドコモの登録商標です。※ はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。※FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。※本製品は下記URLに掲載されているHEVC特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。patentlist.accessadvance.com



株式会社 **ニコン・トリンブル**
<https://www.nikon-trimble.co.jp/>

ジオスパーシャル部
 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-16-2 テクノポート大樹生命ビル